平成21年2月6日

各　　位

上場会社名　　株式会社 東京精密
代表者　　代表取締役会長　　鈴木　貞勝
（コード番号　7729）
問合せ責任者　　代表取締役
業務会社執行役員社長　太田　邦正
（ＴＥＬ　0422-48-1011）

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成20年11月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1.平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想（A）	53,000	1,500	1,100	△ 1,600	△ 39.80
今回発表予想（B）	45,500	△ 2,500	△ 3,000	△ 12,000	△ 298.51
増減額（B－A）	△ 7,500	△ 4,000	△ 4,100	△ 10,400	―
増減率(%)	△ 14.2	―	―	―	―
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期)	91,823	10,450	9,375	4,813	119.84

２．業績予想修正の理由

(1) 米国の金融危機が実体経済に波及し、世界的な景気後退が激しく進む状況下、当社の半導体事業および計測事業とも事業環境が非常に厳しくなっています。景気低迷に円高が加わり、売上高が大幅に減少し、営業利益、経常利益とも11月の予想を下回る見込みです。

(2) 当社は、このような厳しい事業環境を踏まえて、半導体事業の選択と集中を強力に進めるとともに、より一層固定費の削減に注力することといたしました。

具体的な実施事項は次のとおりです。

① 検査工程のウエーハ・プロービングマシンと後工程のウエーハ・ダイシングマシン、ポリッシュ・グラインダをコア事業として位置づけ、人員やリソースを集中いたします。

② ウエーハ外観検査装置事業については、新たな開発・製造を凍結し、現行機種のサポートのみを行ってまいります。

③ デバイス・エッジ事業についても、開発・製造を凍結するとともに、事業を推進してきた当社の子会社であるAccretech USA, Inc.の解散および清算を決定いたしました。

④ 上記の半導体事業の見直しとともに、収益構造の改善を図り、安定的な経営基盤を構築していくために、希望退職者の募集を決定いたしました。

以上から、ウエーハ外観検査装置の事業整理損失が約47億円、子会社清算に伴う損失が約25億円見込まれ、それに希望退職者募集に伴う特別加算金や株式評価損などの損失が加算されます。合計で約82億円の特別損失の下期追加計上を見込んでいます。経常利益の減少にこれらを加えて当期純利益の予想を修正いたします。

以上